



SUOMI—FINLAND
(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

PATENTTIHAKEMUS—PATENTANSÖKAN

[A] TIIVISTELMÄ—SAMMANDRAG

(11)(21) Patenttihakemus—Patentansökan 891740
(51) Kv.lk.⁴/Int.cl.⁴ C 25 F 3/00 // G 03 F 7/00,
H 05 K 3/06
(22) Hakemispäivä—Ansökningsdag 12.04.89
(23) Alkupäivä—Löpdag
(41) Tullut julkiseksi—Blivit offentlig 14.10.89
(86) Kv. hakemus—Int.ansökan
(30) Etuoikeus—Prioritet 13.04.88 DE P 3812315.0

(71) Hakija/Sökande: *Siemens Aktiengesellschaft*, Wittelsbacherplatz 2, Muenchen, Saksa-BRD

(72) Keksijät/Uppfinnare: 1. Buerk, Hermann 2. Wagner, Thomas 3. Steinhäuser, Michael

(74) Asiamies/Ombud: Berggren

(54) Keksinnön nimitys/Uppfinningens benämning: Menetelmä fotolakkakeroksen poistamiseksi. Förfarande för avskiktande av fotolack.

(57) Tiivistelmä

Keksintö kohdistuu menetelmään fotolakkakerrosten poistamiseksi. Etenkin fluori-ripitoisella syövytyskaasulla suoritettun syövytyksen kovettama fotolakka (5) voidaan poistaa merkäkemiallisesti nykyisissä poistolaitteissa vain erittäin vaikeasti eikä yleensä täydellisesti. Keksinnön mukaan esitetään menetelmä, jossa alkalisen kerroksenpoistokylvyn tehostamiseksi suoritetaan elektrolyysi, jossa kovettunutta fotolakkarakennetta (5) kannattava substraatti (1) kytketään katodiksi. Veden elektrolyytissä hajoamisessa suoraan substraatin pinnalle tai vapaille metallipinnoille (3, 4) syntyneet kaasut poistavat täydellisesti alkalisen kylvyn jo irrottaman fotolakkarakenteen (5). Erikoisen vaikeissa tapauksissa menetelmä voidaan yhdistää johonkin toiseen kerroksenpoistoprosessiin, esimerkiksi happiplasmassa suoritettuun "puhdistukseen". Uusi menetelmä on yksinkertainen ja lisäksi kustannuksiltaan edullisempi ja nopeampi suorittaa kuin tunnetut menetelmät.

(57) Sammandrag

Uppfinningen avser ett förfarande för avskiktande av ett fotolack. Ett särskilt genom etsning med fluorhaltig etsningsgas härdat fotolack (5) kan avskiktas våtkemiskt i nuvarande avskiktsanordningar bara ytterst svårt och i allmänhet inte fullständigt. Enligt uppfinningen föreslås ett förfarande, i vilket för effektivisering av ett alkaliskt avskiktsbad utförs en elektrolys, där ett den härdade fotolackstrukturen (5) bärande substrat (1) kopplas som en katod. Gaser, som alstras genom ett elektrolytiskt sönderfall av vattnet direkt på substratytan eller fria metallytor (3, 4), avskiktat helt den genom det alkaliska badet lossnade fotolackstrukturen (5). I särskilt svåra fall kan förfarandet kombineras med en annan avskiktsprocess, t.ex. med "en reningsprocess" i syreplasma. Det nya förfarandet är enkelt och också förmånligare i kostnader och snabbare att utföra än kända förfaranden.

